檔　　號：
保存年限：

電子公文

明新學校財團法人明新科技大學　函

機關地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號
聯絡人：何宗穎
電子信箱：zyho@must.edu.tw
聯絡電話：(03)5593142分機3270
傳真電話：(03)5595142

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國111年11月14日
發文字號：明新（半）字第1110011840號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：附件如說明一(附件一 A09610000Q0000000_1111201911_1_attch1.pdf、附件二 A09610000Q0000000_1111201911_2_attch2.pdf)

主旨：誠摯邀請工程專業領域的大學及高中職教師，報名參加明新科技大學111學年度教師產業研習「半導體封裝製程與設備實務培訓營」培訓課程，活動資訊詳如說明，請周知所屬單位查照。

說明：

一、為提升教師多元實務專長，教育部特補助本校辦理半導體封裝製程與設備實務培訓課程；培訓課程內容有半導體封裝製程及設備實務兩個部份，並由專業學者與業師共同授課；封裝製程主要講授傳統封裝、高階封裝及先進封裝製程等專業知識；設備實務則訓練晶圓切割機、固晶機及打線機的實務操作能力；ＱＦＮ自動機台操作訓練則有機台介紹、製程參數設定及機台運轉測試；本研習課程邀請貴校教師踴躍參加，研習課程請詳閱活動簡章（附件1）及活動海報（附件2）各1份。

二、研習相關資訊：

(一)本研習課程分兩梯次研習時段：

１、第一梯次：112年1月30日（星期一）至2月10日（星期五），共10天，上午8時30分至下午4時30分。

國立勤益科技大學
1110061801　111/11/16

2、第二梯次：112年7月3日（星期一）至7月14（星期五），共10天，上午8時30分至下午4時30分。

(二)研習地點：明新科技大學明學樓205教室、明新科技大學半導體封裝測試類產線基地。

(三)參加培訓人數30人（名額有限滿額為止）。

三、報名方式：

(一)報名時間：111年11月25日至12月30日

(二)報名網址：https://forms.gle/4hipgy9nkyBj5VYs5

四、報名洽詢：明新科技大學半導體學院類產線計畫辦公室何宗穎助理，電話：(03)5593142分機3270

正本：各公私立高級職業學校、各公私立大專校院
副本：本校半導體學院 111/11/16 08:34:30